

非硅导热软质垫片 XK-PN60

简介:

XK-PN 是无硅氧烷挥发材料,适用于硅敏感的应用, 比传统非硅材料有更低的硬度, 提供更高的变形量与更高的导热性质.

特性:

无硅氧烷挥发

高导热

高绝缘

高变形量

应用:

硬盘

光学精密设备



	unit	XK-PN60	Method
颜色 Color		Gray	visual
厚度 Thickness	mm	0.5~3.0	ASTM D374
比重 Specific Gravity	g/cm ³	3.2	ASTM D792
硬度 Hardness	Asker C	40	JIS K7312
	Shore 00	75	ASTM D2240
热阻抗 Thermal impedance@0.5mm	°Cin ² /W	0.13	ASTM D5470
导热系数 Thermal Conductivity	W/mK	6.0	HOT DISK
体积电阻 Volume Resistivity	Ωcm	>10 ¹³	ASTM D257
击穿电压 Breakdown Voltage	KV/mm	>10	ASTM D149
介电常数 Dielectric Constant	1	8	ASTM D150
使用温度 Application temperature	°C	-40~125	
抗张强度 Tensile strength	psi	10	ASTM D149
伸长率 Elongation	%	20	ASTM D149
硅氧烷含量 Siloxane Volatiles D4~D20	%	0	GC-FID
阻燃性 Flammability	UL94	V-0	UL94